



### 1. 2013年度 ECALGA セミナー開催報告

2013年11月26日（火）に「2013年度 ECALGA セミナー」を開催しました。

EC センターでは、IT・エレクトロニクス業界における企業間の全業務プロセスを電子的にグローバル且つシームレスに繋ぎ、相互の経営効率向上を目指した業界標準・ECALGA (Electronic Commerce Alliance for Global business Activity) の啓蒙・普及活動を行っており、この一環として例年、ECALGA セミナーを開催しています。

今回は、ECALGA 標準が EIAJ-EDI を包含している視点から整理した変遷と特徴についての紹介、BtoB 方式により実施した技術情報交換の実証実験結果を受けて改訂した標準書や導入ガイド、これらを支える IT インフラや各種ツール類の紹介の他、アジアを中心とした ECALGA 海外取引標準の活用事例の発表を行いました。

【日時】2013年11月26日（火）

13:30～17:00

【会場】JEITA 409～412会議室

【受講者数】100名

【概要】

#### ① EIAJ-EDI を継承した ECALGA 標準

1989年に業界標準として EIAJ-EDI 標準を初めて策定した後、2003年にはインターネットと XML 技術を取り入れた ECALGA 標準の初版を発行し、改訂を積み重ねてきました。

ECALGA 標準が EIAJ-EDI を包含している視点から整理するとともに、ECALGA 標準の変遷と特徴を改めてまとめ、ECALGA 標準を総括的に紹介しました。

#### ② ECALGA を支える IT インフラ

情報技術委員会では、ECALGA 標準を支える IT インフラの健全性を担保するた

めに、企業間における全てのデータ交換を 1 インタフェースで実現することを目指した ASP 連携標準、Web-EDI 認定などの活動を行っています。

これら EIAJ-EDI 標準から ECALGA 標準までを支える IT インフラ検討の変遷と現在の活動状況を紹介しました。また、今後の IT インフラの方向性と想定活用事例の紹介も行いました。

#### ③ ECM 分野の EDI 普及に向けて

BtoB 方式により実施した技術情報交換 (ECALS コンテンツ) の実証実験結果を受けて、ECM 委員会では技術情報交換の ECALGA 標準の見直しを行い、ECALGA 標準 Ver-2012A-Rev02 をリリースし、導入ガイドもリニューアルしました。また、これらを支援するツール類の機能アップも行いました。これらについて詳細に説明を行いました。

また、キャノン (株) 様、KOA (株) 様が技術情報交換の活用事例を発表されました。最後に ECM 委員会の今後の活動計画、技術情報交換の普及拡大に向けた諸施策について紹介を行いました。

#### ④ アジアを中心とした ECALGA 海外取引標準の活用事例

海外進出している日系企業と現地取引企業との情報交換の利便性向上を目的に 2011 年 ECALGA 海外取引標準が制定されました。これにより、特に中国・アジアなど EDI 標準が制定されていない国・地域では、効率的かつ短期間での EDI 化が推進可能となり、ECALGA 海外取引標準が展開されています。その活用事例や導入時の課題と解決策について、既に導入実績のある (株) 日立製作所様より紹介を頂きました。

今回のセミナーは、ユーザに対して、ECALGA 標準が EIAJ-EDI を包含している点をアピールすることを一つの主眼とした。アンケート回答によると、このアピールは成果をあげたと思われます。

また、IT インフラの方向性、技術情報交換の今後の諸施策などの将来展開について

も大きな評価を得ることができ、海外取引標準の活用事例は、大いに参考にしたい旨の意見が多数寄せられました。

この他、貴重なご意見、ご要望を多数いただきました。これらに関連する委員会にて検証して、今後の EC センター活動へ反映してまいります。



熱心に聴講する参加者

## 2. ECALGA 標準 (ECM) Ver2012A-Rev02 リリース

ECALGA 標準書のⅣ 業務モデル編 (ECM)、Ⅴ ビジネス辞書編 (ECM) の Ver2012A - Rev01 の発行後に実施した BtoB による技術情報交換の実証実験で抽出された課題を解決する為に、同 ECALGA 標準を改訂し、版を「Rev02」と改めて発行しました。

改訂の概略を以下に記します。

### ① 日付・時刻の表記

日付と時刻の表記に誤解を与えるケースがあった為に、該当項目の定義を具体的な表記（日付：yyyymmdd、時刻：hhmmss）に修正しました。

### ② ビジネスアクション ID に設定する値

ECM ではビジネスドキュメントヘッダ・ビジネスアクション ID（項目 No.18007）に技術情報区分（項目 No.20002）を指定

することで、ビジネスドキュメント本体明細部を参照することなく技術情報区分を扱うことができるようにします。当内容をビジネスドキュメントヘッダ一定義の欄外に注釈として追記しました。

### ③ 訂正コードの使い方を追記

ビジネスドキュメントの項目の一つに訂正コード（項目 No.00009）があります。この訂正コードの使い方を追記しました。

### ④ 漢字属性の桁数の見直し

漢字属性（K(n)）では、入力できる全角文字の文字数は最大で n/2 文字となります。ビジネスドキュメントで定義した漢字属性の項目で文字数が不足すると思われる項目があった為に、漢字属性を持つ項目をベースに桁数の見直しを行いました。

### 3. ECALS 辞書 Ver15.1一般公開

ECALS 辞書 Ver15.1を2013年11月22日に EC センターのホームページにて、一般公開しました。

今回、クラスの新設は、半導体の新たな製品である IPD (Intelligent power device) の1クラスのみです。

また、Ver14.1でクラスを新設したが、プロパティを設定していなかった蛍光表示管の下層クラスについてプロパティを新設した。他にもシャント抵抗器、チョークコイル等でプロパティの充実を図りました。

修正項目は多数あるが、その殆どは英語定義の見直しです。

誌面の都合上、ここでは「新設クラス」「プロパティを新設したクラス」「改訂規模」「Ver14.1との比較」のみを掲載します。

#### ②プロパティを新設したクラス

- ・シャント抵抗器 (XJB037)
- ・ノーマルモードチョークコイル (XJA757)
- ・ハイブリッドチョークコイル (XJA817)
- ・メモリ (XJA643)
- ・モータドライバIC (XJA670)
- ・IPD (XJB066)
- ・セグメント型蛍光表示管 (XJB061)
- ・アルファニューメリック型蛍光表示管 (XJB062)
- ・ドットキャラクタ型蛍光表示管 (XJB063)
- ・フルドットマトリックス型蛍光表示管 (XJB064)
- ・ハイブリッド型蛍光表示管 (XJB065)

#### ①クラスの新設は以下の「IPD (XJB066)」のみ。 ※ ( ) 内は階層を表す。

- |-(1) 専用 IC (XJA661)
- |-(2) IPD (XJB066) 【新設】

#### ③ ECALS 辞書 Ver15.1の改訂規模

		共通	一般電子部品	半導体	液晶	水晶	合計
クラス	新設	0	0	1	0	0	1
	廃止	0	0	0	0	0	0
	変更	0	13	103	3	0	119
プロパティ	新設	0	10	14	37	0	61
	廃止	0	3	2	0	0	5
	変更	0	139	1024	4	0	1167
プロパティバリュー	新設	0	14	4	86	0	104
	廃止	0	0	0	0	0	0
	変更	0	10	165	0	0	175

#### ④ ECALS 辞書 Ver14.1との比較

	Ver 14.1	Ver 15.1	増減
クラス	671	672	1
プロパティ	4145	4201	56
プロパティバリュー	3606	3710	104

#### 4. IBIS Quality Framework 展示会報告 (CEATEC / EDS Fair)

JEITA/EC センター EDA 標準 WG では、伝送線路シミュレーションに使用される IBIS モデルの品質向上のため「IBIS Quality Framework」サイトを立ち上げ、HP にて一般公開しています。

この度、JEITA / EC センター EDA 標準 WG では、DDR2 (Double Data Rate 2) の IBIS モデル、SPICE モデルにてシングルエンド高速 (800Mbps) の解析を行いました。

解析の結果、IBIS シミュレーションでも SPICE シミュレーションと同等の解析結果を得たことから、シングルエンド高速での IBIS モデルの有効性を確認し、各社のシングルエンド高速「Golden Input」データを「IBIS Quality Framework」に掲載しました。

これの普及・啓蒙活動の一環として CEATEC JAPAN 2013 および EDS Fair 2013 にてブース展示を行いました。

##### 【展示概要】

###### ■ CEATEC JAPAN 2013

日時：2013年10月1日(火)～10月5日(土)  
場所：幕張メッセ (2小間)

###### ■ EDS Fair 2013

日時：2013年11月20日(水)～11月22日(金)  
場所：パシフィコ横浜 (2小間)

##### 【展示内容】

###### ■ パネル展示 (3点)

1. 伝送シミュレーションの現状
  - ・ SPICE は入手困難で解析時間も長い。
  - ・ IBIS は入手が容易で解析時間も短い、実測と合わないケースもある。
2. IBIS モデルを取り巻く現状
  - ・ IBIS シミュレーションと実測が合わない場合、原因究明は容易ではない。
3. IBIS Quality Framework 概要

- ・ SPICE・IBIS 合致したデータ (Golden IBIS・Golden results・Golden Input) を活用することにより、精度の高いシミュレーションが可能。
- ・ これらデータは EC センター HP よりダウンロードでき、誰もが利用可能。

###### ■ IBIS Quality Framework の紹介映像 (約4分)

- ・ ブース内にて、ビギナーの方にも分かりやすい紹介映像をリピート再生した。

###### ■ 配布資料

- ・ IBIS Quality Framework カタログ
- ・ SI シミュレーション・モデル解説書抜粋版
- ・ IBIS Quality Framework 詳細資料
- ・ インターコネクト・モデルの検証資料



IBIS Quality Framework ブース全景



熱心に説明を行う EDA 標準 WG メンバー

## 5. IBIS Summit in Japan 開催報告

2013年11月22日（金）、パシフィコ横浜アネックスホールにおいて、IBIS Summit in Japan を開催しました。昨年同様、今回も EDS Fair の会期中にパシフィコ横浜で開催し、多数の設計開発者が参加しました。

今回はシミュレーションビギナーから上級者まで、広いターゲットを狙いテーマ設定を行いました。プレゼン内容は以下の通りです。1つのテーマを発表するごとにディスカッションを行い、有意義な意見交換ができました。

参加者：120名

- プレゼン内容
- ① IBIS 6.0の概要
  - ② ビギナーにとって、今 IBIS モデルに求められる事
  - ③ IBIS5.x と SPICE モデルとの比較検証
  - ④ オーバークロックソリューションを伴うバッファモデルについて
  - ⑤ SSO アナライズのための IBIS モデル
  - ⑥ IBIS-AMI の構造と動作

[IBIS] : I/O Buffer Information Specification

[IBIS AMI] : IBIS Algorithmic Modeling Interface

[SPICE] : Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis

[SSO] : Simultaneous Switching Output



熱心に聴講する参加者



講演する IBIS Open Forum 議長の Michael Mirmak 氏 (Intel)

参加者から多数のアンケート回答を頂きました。アンケートによると IBIS5.x と SPICE モデルとの比較検証のプレゼンテーションが大いに参考になったとの声が多くみられました。

また、IBIS-AMI の実用に目途がたった旨の報告があり、この実用に期待感が高まりました。その他、貴重な意見も多く頂き、これらを今後の活動に役立ててまいります。